



アンポック株式会社
AMPOC Far-East Co., Ltd.

業界初 縦型現像、剥離装置

コンタクトフリーのウェット装置

縦型装置で解決

- 搬送用リングホイールによる傷(搬送痕防止)
- 搬送用リングホイールによるレジストの倒れ込み防止
- 剥離後、DFRリングホイールへの張り付きによる基板への再付着の防止

特長

- 薄物対応
厚さ50 μ mの基板に対応
基板にダメージを与えずに薄物基板の処理が可能
- 搬送痕がつかない完全コンタクトフリーを実現
- ロボット搬送システムによる全自動生産
- クランプ部分の液だまりは解決済み



日本、台湾、中国での特許取得



外周吸着での自動ロードアンローダ



水平で流れてきた基板処理が可能



基材に負荷をかけない基板取付



オートローディングの基板搬送治具



縦型搬送による完全コンタクトフリー



株式会社 サーマプレジジョン
Cerma Precision, Inc.